

2025年3月期 第4四半期 決算説明会 Q&A

■ 質問一覧

- Q1 WFE 市場について、中国以外の世界市場のアプリケーション別の見通しと、中国市場の見通しを併せて教えてください。また、米国の関税措置の発表を受けて、顧客の投資スタンスに変化はみられるか？
- Q2 今年も中国における半導体メーカーの投資が一定程度期待される一方で、今後一段と中国への輸出規制が強まる可能性もあると思われる。足元の中国 WFE 市場の変化やこの先の規制の影響をどうみているか？
- Q3 中国における、米国および中国地場の装置メーカーとの競合状況について、教えてください。
- Q4 FY2026 の業績予想に関して、前半期比で売上高と利益率が上期に下がり、下期に上昇する理由を説明してほしい。
- Q5 FY2026 の上期・下期の需要がどの程度見えているのか教えてください。また、上期への前倒しの可能性についても伺いたい。
- Q6 FY2025 下期の NAND 向け売上が前半期比で増加した要因、ならびに FY2026 売上が前期比で増加する要因を教えてください。
- Q7 FY2026 SPE 新規装置売上予想において、DRAM 向け売上が FY2025 比 2 割弱減る。その要因は？
- Q8 関税措置に関する業績への影響について想定を教えてください。
- Q9 FY2026 の研究開発費・設備投資の予算が大幅に増えているようだが、中期的な見通しとして、どのような水準になるか？特に設備投資の規模については著しく増加していくのか？
- Q10 大規模な研究開発投資・設備投資をおこなっていくという方針にここ 1-2 年で変わってきている。こうした投資の回収時期や中期経営計画で目標として掲げている営業利益率の達成時期についてはどう考えているか？
- Q11 FY2025 のボンダー/デボンダーの売上が 300 億円に達したが、FY2026 と FY2027 の見通しは？
- Q12 CY2024 の絶縁膜エッチングのシェアは 60%に達し、大きく増加したが、CY2026 のシェアはどの程度と見ているか？



■ Q&A

Q1 WFE*1 市場について、中国以外の世界市場のアプリケーション別の見通しと、中国市場の見通しを併せて教えてほしい。また、米国の関税措置の発表を受けて、顧客の投資スタンスに変化はみられるか？

A1 CY2024 は、中国以外の世界市場が全体の 55% で、その内訳は DRAM 17%、NAND 5%、先端ロジック 20%、その他 13% であった。中国については全体の 45% 程度で、そのうちの 7 割がロジックであったとみている。

CY2025 は、DRAM 20%、NAND 10%、先端ロジック 20%、その他 15%、中国については全体の 35% 程度で、そのうちの 8 割がロジックという見通しである。中国 WFE 市場の比率は全体として、10 ポイント程度、昨年より小さくなるとみている。

CY2026 は、詳細は控えるが、DRAM は先端の顧客の投資が増え CY2025 より成長し、NAND は CY2025 と同等の投資水準と予想している。一番のけん引役は最先端ロジックとみている。なお、現時点では中国市場が大きく回復すると想定しておらず、CY2026 の中国市場は CY2025 とほぼ同水準。関税措置発表後の顧客の投資スタンスについても、全体的な見方は変わっていない。

[▲Top](#)

Q2 今年も中国における半導体メーカーの投資が一定程度期待される一方で、今後一段と中国への輸出規制が強まる可能性もあると思われる。足元の中国 WFE 市場の変化やこの先の規制の影響をどうみているか？

A2 中国への輸出規制について、緩和されるとは見えていない。従前から把握している内容は織り込んで予想を立てており、特に直近で変化はないと捉えている。

[▲Top](#)

Q3 中国における、米国および中国地場の装置メーカーとの競合状況について、教えてほしい。

A3 米国装置メーカーとの競争関係は変わらない。当社は規制に乗じたバックフィルはせず、フェアな競争に努めている。

中国地場装置メーカーは、国策の恩恵もあり、中国国内で大きくシェアを伸ばしている。昨今の規制の状況に鑑みると、中国装置メーカーも売上を伸ばしていくと予想している。

このような環境のなかでも、半導体の技術革新は進んでいくため、当社の価値を提供する機会は世界全体で増えていく。中国に限らず、グローバルで当社のシェアを伸ばす計画。

[▲Top](#)



Q4 FY2026の業績予想に関して、前半期比で売上高と利益率が上期に下がり、下期に上昇する理由を説明してほしい。

A4 FY2026 上期は、顧客の投資に一服感があり、売上高は FY2025 下期に比べると下がる傾向にある。高い水準の研究開発費や人件費の上昇などもあり利益率も若干低い。
下期については、堅調な AI サーバーに加えて、来年、PC・スマホ関連の投資が期待されており、売上高・利益率とも上昇する見通し。

[▲Top](#)

Q5 FY2026の上期・下期の需要がどの程度見えているのか教えてほしい。また、上期への前倒しの可能性についても伺いたい。

A5 FY2026 上期については、ほとんどの案件を既に受注している状況のため、かなり固い数字だと考えている。下期についても強い引き合いがある。下期から上期への前倒しについては、顧客の予算の状況次第で要請がくる可能性はあるが、最も確からしいと考える業績予想を発表した。

[▲Top](#)

Q6 FY2025 下期の NAND 向け売上が前半期比で増加した要因、ならびに FY2026 売上が前期比で増加する要因を教えてほしい。

A6 FY2025 においては、NAND 市場が緩やかに回復している中、当社のシェアも上昇した。CY2025 においては NAND 向け投資が成長しており、FY2026 の売上増に貢献する見込み。なお、現在の投資はグリーンフィールド投資（キャパシティ増強投資）ではなく、ブラウンフィールド投資（技術移行投資）であり、この引き合いが非常に大きくなってきている。

[▲Top](#)

Q7 FY2026 SPE 新規装置売上予想において、DRAM 向け売上が FY2025 比 2 割弱減る。その要因は？

A7 FY2026 の DRAM 向け売上は前年比減少するが、CY ベースでは WFE 市場を少し上回る成長を期待できる。なお、中国における DRAM 向け投資は下がるが、中国以外は伸びる想定。中国を除くと 10%以上の増収が期待できる。

[▲Top](#)



Q8 関税措置に関する業績への影響について想定を教えてください。

A8 現時点で、当社に影響があるとみられる北米での売上見通しは FY2026 売上全体の 8%程度であり、限定的と考えている。今後の動向を注視するとともに、決定事項があれば、それに合わせてベストな解を、顧客との協議に基づいて探していきたい。たとえ、関税がかかったとしても、それを凌ぐような生産性メリットを出せる新製品の創出を急ぐ。我々の使命は、半導体の技術革新と半導体製造における高い生産性への貢献。これこそが、半導体製造装置メーカーの存在意義であり、我々のビジネスの一丁目一番地として捉え、適切に対応していきたい。

[▲Top](#)

Q9 FY2026 の研究開発費・設備投資の予算が大幅に増えているようだが、中期的な見通しとして、どのような水準になるか？特に設備投資の規模については著しく増加していくのか？

A9 FY2025 から 5 年間で 1.5 兆円以上の研究開発投資、7,000 億円以上の設備投資という計画を発表しているが、今後の市場と当社の成長ポテンシャルを考えると、その計画を緩めるつもりは一切ない。FY2026 の設備投資については、宮城・熊本の開発棟が今年竣工を迎えるため、インパクトとしては大きく、1,000 億円規模の投資となる宮城の生産新棟も FY2026 以降、投資の増加につながる。今後も一定の規模の投資は続くと予想され、マクロ経済の動向や半導体の市況を見ながら判断していきたい。

[▲Top](#)

Q10 大規模な研究開発投資・設備投資をおこなっていくという方針にここ 1-2 年で変わってきている。こうした投資の回収時期や中期経営計画で目標として掲げている営業利益率の達成時期についてはどう考えているか？

A10 やみくもに成長投資を実施しているわけではない。対売上高固定費比率のレビューを四半期ごとに実施するなど、利益率向上に向けた取り組みをおこないながら進めている。FY2026 の下期は、売上高 1 兆 4,500 億円、営業利益率 30%以上を計画している。例えば、この計画を 2 半期連続で達成すると、売上高は中期経営計画の目標値に近づく。営業利益率 35%以上は、野心的な目標だが、AI サーバー向けや PC・スマホ向けの高付加価値製品の比率がこれからさらに上がってきて、売上総利益率の向上に貢献すると期待している。FY2027・FY2028 に向けて順調に成長軌道に乗っているという評価をしている。

[▲Top](#)

Q11 FY2025 のボンダー/デボンダーの売上が 300 億円に達したが、FY2026 と FY2027 の見通しは？

A11 FY2025 のボンダーの売上は FY2023 比で約 3 倍になった。HBM² 向けのテンポラリーボンダー/デボンダーだけではなく、ロジックの Backside PDN³ や 3D NAND 向けボンダーの評価を進めており、今後も大きな成長が期待できる。

[▲Top](#)



Q12 CY2024の絶縁膜エッチングのシェアは60%に達し、大きく増加したが、CY2026のシェアはどの程度と見ているか？

A12 エッチングはとてエキサイティングな状況。先端分野において成長機会が非常に大きい。特にDRAMのキャパシタエッチングは圧倒的なポジションにある。他、NANDの極低温エッチングとスリット工程、アドバンスドパッケージングの配線工程においてエッチングビジネスはこれから数年でさらに成長していく。極低温エッチングを採用する400層レベルの3D NANDの本格量産はCY2026から始まり、売上に貢献する。顧客1社で量産POR*4、他2社は評価が進んでいる。当社は極低温エッチング技術に加え、RFの正弦波を矩形波に補正しイオンの入射角の垂直性を高めるなど、競合にはない技術を導入し差別化を図っている。

[▲Top](#)

*1 WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

*2 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅メモリ

*3 Backside PDN (Power Delivery Network) : 電源供給配線をウェーハの裏面に配置する構造

*4 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

FY2023は2022年4月～2023年3月の会計年度を指しています。

FY2024は2023年4月～2024年3月の会計年度を指しています。

FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。

FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

FY2027は2026年4月～2027年3月の会計年度を指しています。

FY2028は2027年4月～2028年3月の会計年度を指しています。

本内容は質疑応答のサマリーです。スライドに同期した音声配信は[こちら](#)から。